

エッティング剤(銅系、鉄系、SUS系、チタン系)

| 商品名 | 特徴 | 品番・作業条件 | 荷姿 | 用途 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| ET-50 | ■酸化剤系の銅のエッティング剤 ●めっき前の粗面化 ●マイルドなエッティング ●密着をよくする | ET-50A 60ml/l ET-50B 200g/l | 20L 20kg | ○銅合金 ●OFC材 ●リードフレーム ●PCB、FPC |
| ET-50AMS | | ET-50AMS 60ml/l ET-50BN 200g/l | | |
| ET-50TN | | ET-50A 60ml/l ET-50BN 200g/l | | |
| ET-50FN | ■酸化物系、鉄及び銅材のエッティング剤 ●銅の除去(拡散した銅) | 500ml/l～原液使用 | 20L | ○DBC ●焼結体 ●Cu材 |
| ET-50F2 | ■ステンレスのエッティング剤 ●硝酸系と異なる ●NO ₂ ガスが発生しない ●金属酸化物の除去 | ET-50F2 250ml/l～原液使用 HCl 0～100ml/l | 20L | ○SUS材 ●リードフレーム ●黒皮除去 |
| MC-E | ■フッ化物系エッティング補助剤 ●HCl、H ₂ SO ₄ との併用 ●酸化皮膜を除去し、 めっき皮膜の密着をよくする ●特にガラス質の除去 ●Si、SiO ₂ その他の酸化物の除去 ●SUS材のめっき密着改良 | MC-E 100ml/l～原液使用 HCl、H ₂ SO ₄ 200ml/l | 20L | ○鋳物 ●SUS ●42アロイ ●コバルール ●半導体セラミック ●快削鋼 |
| ASM-200 | ■エッティング液及びガラス上の Niめっき析出防止 ●Ag部材上のエッティング剤 | 200～300ml/l | 20L | ○ハーメチックシール ●水晶振動子 ●半導体レーザーキャップ |
| HM-100 | ■酸性タイプのエッティング剤 ●黒皮の除去 ●カーボンの除去、Ag-Cu、 コバルール拡散層の除去 | 200ml/l～原液使用 | 20L | ○コバルールや42アロイ のピンのエッティング ●水晶振動子 |
| MC-EP | ■フッ化物系エッティング補助剤、 固形酸(粉) ●H ₂ SO ₄ 、HClとの併用 ●酸化皮膜を除去し、 めっき皮膜の密着をよくする ●特にガラス質の除去 ●Si、SiO ₂ その他の酸化物の除去 ●SUS材のめっき密着改良 | MC-EP 50～300g/l H ₂ SO ₄ or HCl 50～200ml/l | 20kg | ○鋳物 ●SUS ●42アロイ ●コバルール ●半導体セラミック ●快削鋼 |
| T-22 | ■チタン用エッティング剤(活性化剤) ●チタン上にめっきを行う時に用いる T-22→リンデンT(ストライクめっき) ●TiO ₂ 膜の除去 | T-22 原液使用 ↓ 80～90°C リンデンT | 20L | ○Ti上の各種めっき |
| Z-100 (酸エマルジョン) | ■酸洗浄力強化剤 ●黒皮、油分、溶接スケールの除去 ●インヒビターにより 過剰エッティングしない | Z-100 50～100ml/l HCl 300～500ml/l | 20L | ○鉄材の黒皮除去 ●スポット溶接部の洗浄 ●水晶振動素子 |